

用途例

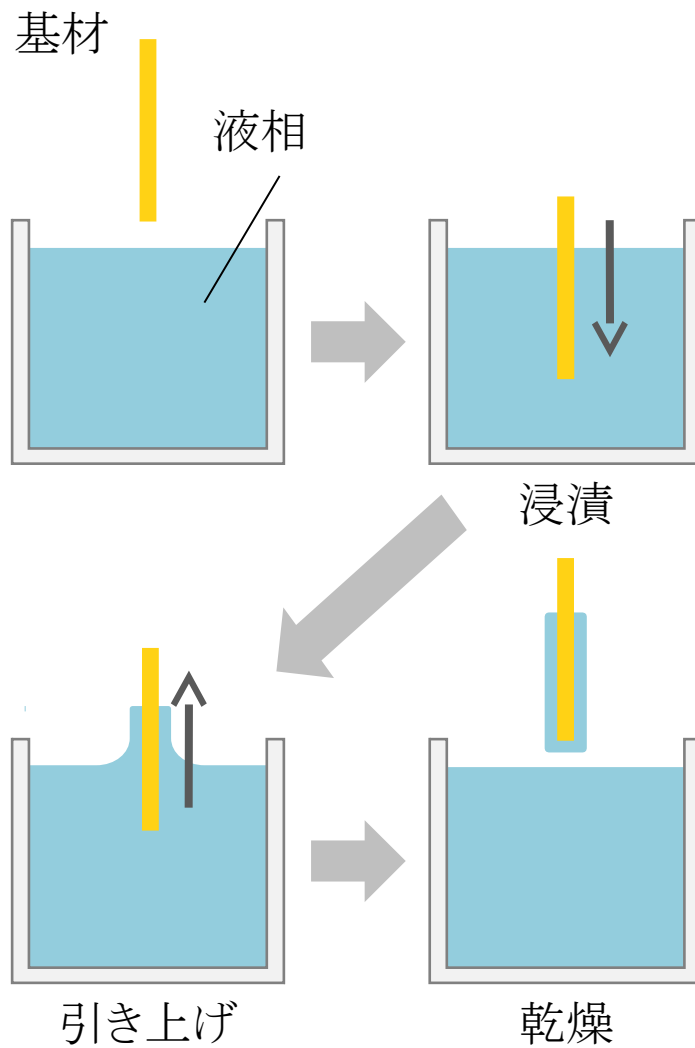
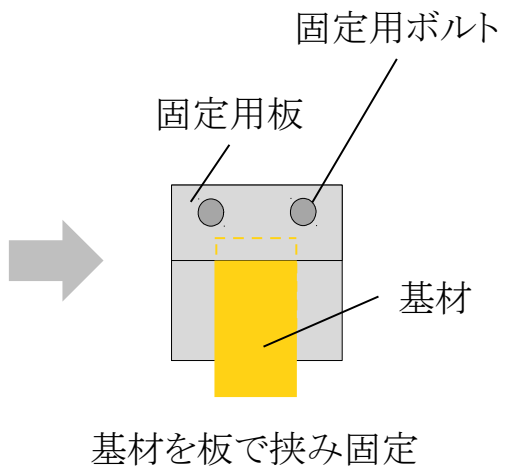
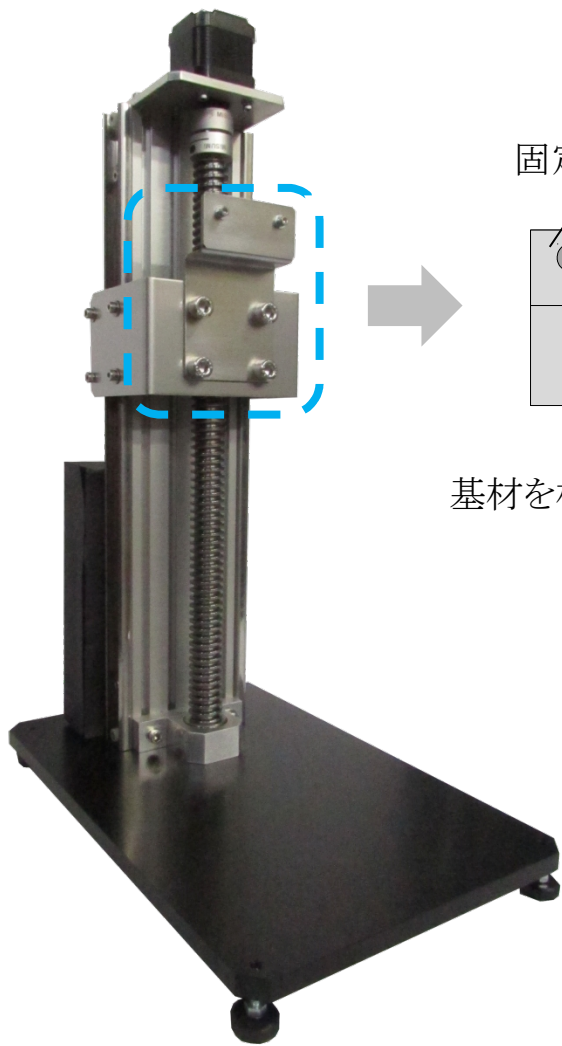
太陽電池	有機太陽電池の塗布工程等
光学レンズ	ARコート等
ハードコート	各種基材の表面硬化
フォトレジスト	半導体製造の塗布工程等
ディスプレイ	各種基板への薄膜形成
燃料電池	導電・絶縁各層の薄膜形成

ディップコーティングとは

液中に基材を浸漬し、

引き上げることで薄膜を形成するコーティング手法

基材引き上げ時の速度によって膜厚の制御を行う



主仕様

ストローク	300mm(推奨サンプルサイズ:φ100)
最小速度(Min)	25μm/sec
最大速度(Max)	10mm/sec
操作方法	PC制御(シリアルケーブル)
運転モード	JOG動作 定値運転 プログラム運転(距離、速度、加減速制御)
プログラム数	無制限
ユーティリティー	AC100V、50VA
重量	5.8kg
寸法	W:200mm D:300mm H:470mm
ステージサイズ	W:200 D:200
その他オプション	風防、ヒーター等のオプションも対応

ディップコーティングの特徴

膜厚制御	引き上げ速度で膜厚制御が可能
両面塗布	一度で基材両面への塗布が可能
平板以外も塗布可能	凹凸のある基材でも取扱い可能
簡単な構造	真空容器等が不要でローコスト・メンテナンス性良
液の無駄が少ない	容器の中で完結するので無駄な液が排出されない